

●SOT-25 パッケージ許容損失

SOT-25 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 40mm×40mm (片面 1600mm²) に対して

銅箔面積 表面 約 50%-裏面 約 50%

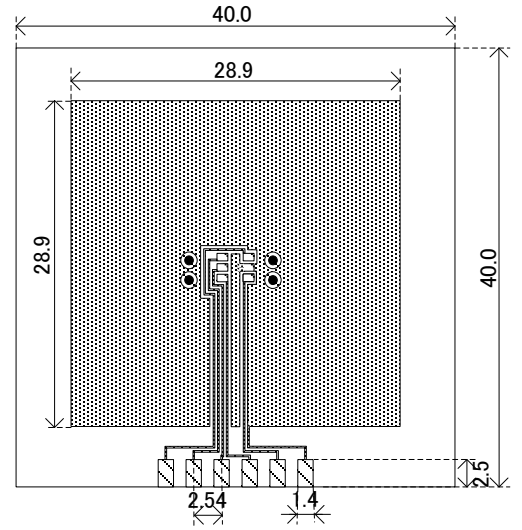
放熱板と周りの銅箔接続

(SOT26 基板を共用)

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4個

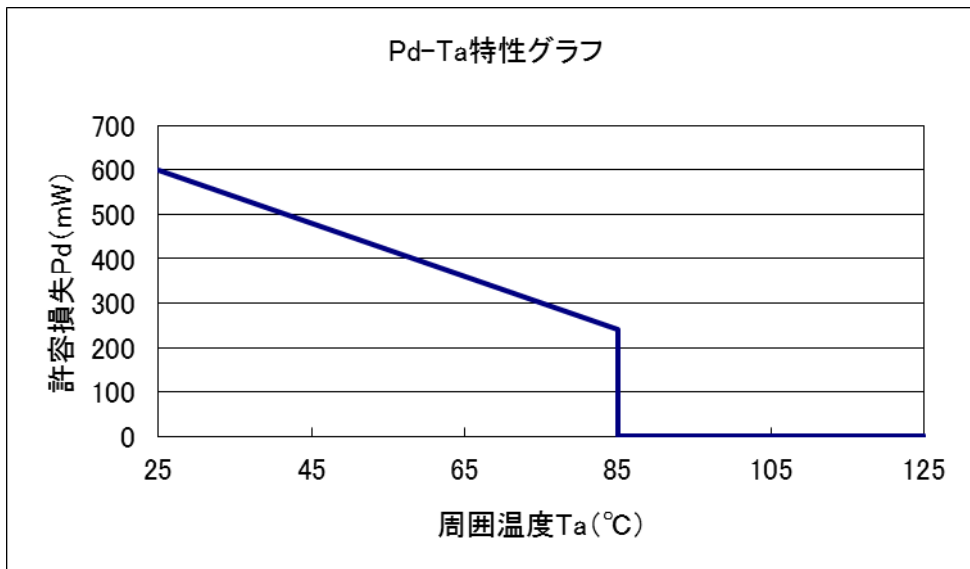


2. 許容損失-周囲温度特性

評価基板レイアウト(単位:mm)

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	$\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$
25	600	166.67
85	240	



●SOT-25 パッケージ許容損失(JESD51-7)

SOT-25 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：4層基板 76.2mm×114.3mm (片面約 8700 mm²)

に対して銅箔面積

1層目：銅箔無し放熱板と周りの銅箔接続

2層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

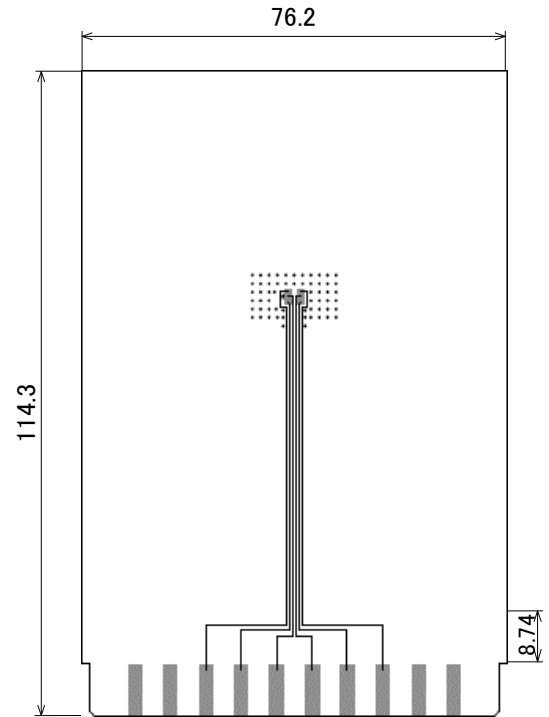
3層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

4層目：銅箔無し

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個

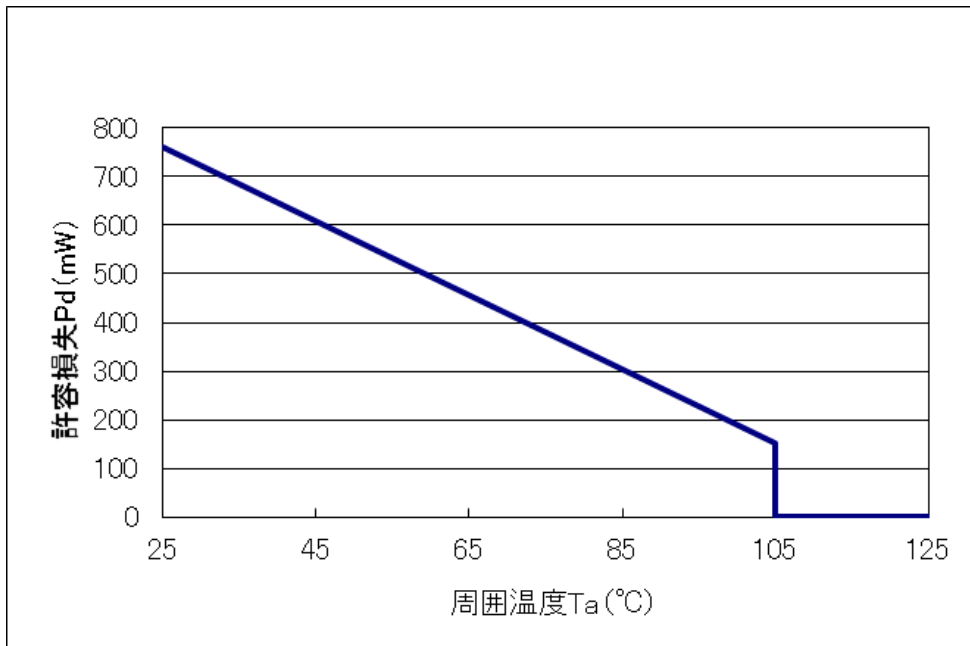


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(T_{jmax}=125°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	θ_a (°C/W)
25	760	131.58
105	152	



● SOT-25パッケージ許容損失 ※Tjmax=150°C

SOT-25パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 基板40mm×40mm(片面1600mm²)に対して

銅箔面積 表面 約50%-裏面 約50%

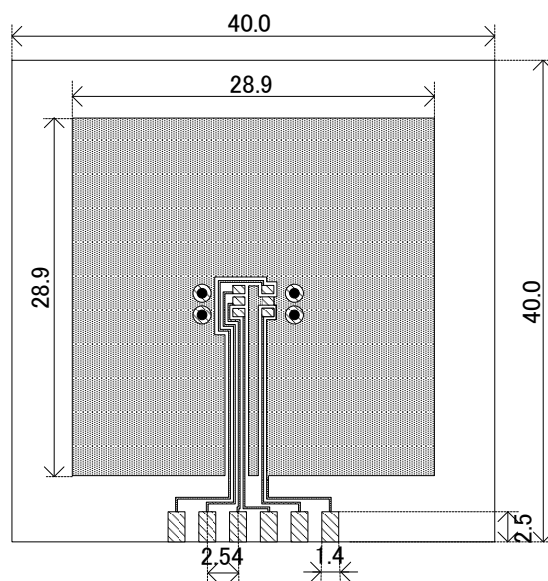
放熱板と周りの銅箔接続

(SOT-26基板を共用)

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2.許容損失-周囲温度特性

基板実装(Tjmax = 150°C)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)		θ_{ja} (°C/W)
	Ta max=125°C	Ta max=150°C	
25	750	750	166.67
125	150	150	
150	0	0	

